

会 社 名 **サムコ 株式会社**

上場取引所 J A S D A Q

コード番号 6 3 8 7

本社所在都道府県 京都府

(URL <http://www.samco.co.jp>)

本 社 所 在 地 京都府京都市伏見区竹田藁屋町 36 番地

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 辻 理

問 合 せ 先 責 任 者 管 理 本 部 長 兼 経 理 部 長 田 井 彰

中 間 決 算 取 締 役 会 開 催 日 平 成 17 年 3 月 18 日

中 間 配 当 支 払 日 平 成 - 年 - 月 - 日

T E L (075) 621 - 7841

中 間 配 当 制 度 の 有 無 有

単 元 株 制 度 採 用 の 有 無 有 (1 単 元 100 株)

1. 17 年 1 月中間期の業績 (平成 16 年 8 月 1 日 ~ 平成 17 年 1 月 31 日)

(1) 経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 1 月中間期	1,541	(8.8)	127	(36.3)	112	(35.6)
16 年 1 月中間期	1,690	(1.4)	200	(0.3)	175	(5.8)
16 年 7 月期	3,374		434		411	

	中間(当期)純利益		1 株 当 た り 中 間 (当 期) 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 中 間 (当 期) 純 利 益
	百万円	%	円 銭	円 銭
17 年 1 月中間期	70	(34.0)	14 48	
16 年 1 月中間期	107	(4.0)	21 94	
16 年 7 月期	251		50 71	

(注) 1. 持分法投資損益 17 年 1 月中間期 百万円 16 年 1 月中間期 百万円 16 年 7 月期 百万円

2. 期中平均株式数 17 年 1 月中間期 4,889,140 株 16 年 1 月中間期 4,889,140 株 16 年 7 月期 4,889,140 株

3. 会計処理の方法の変更 無

4. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

5. 期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式控除後のものです。

(2) 配当状況

	1 株 当 た り 中 間 配 当 金	1 株 当 た り 年 間 配 当 金
	円 銭	円 銭
17 年 1 月中間期	0 00	
16 年 1 月中間期	0 00	
16 年 7 月期		15 00

(3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1 株 当 た り 株 主 資 本
	百万円	百万円	%	円 銭
17 年 1 月中間期	6,939	4,957	71.4	1,014 02
16 年 1 月中間期	6,991	4,790	68.5	979 86
16 年 7 月期	6,997	4,982	71.2	1,018 48

(注) 1. 期末発行済株式数 17 年 1 月中間期 4,889,140 株 16 年 1 月中間期 4,889,140 株 16 年 7 月期 4,889,140 株

2. 期末自己株式数 17 年 1 月中間期 1,750 株 16 年 1 月中間期 1,750 株 16 年 7 月期 1,750 株

(4) キャッシュ・フローの状況

	営 業 活 動 に よ る カ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	投 資 活 動 に よ る カ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	財 務 活 動 に よ る カ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17 年 1 月中間期	21	24	145	966
16 年 1 月中間期	254	12	235	1,240
16 年 7 月期	405	69	407	1,170

2. 17 年 7 月期の業績予想 (平成 16 年 8 月 1 日 ~ 平成 17 年 7 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金		
				中 間	期 末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
	3,500	455	273	12 50	12 50	

(参考) 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 55 円 16 銭

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる場合があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、添付書類の 7 ページを参照してください。

添付書類

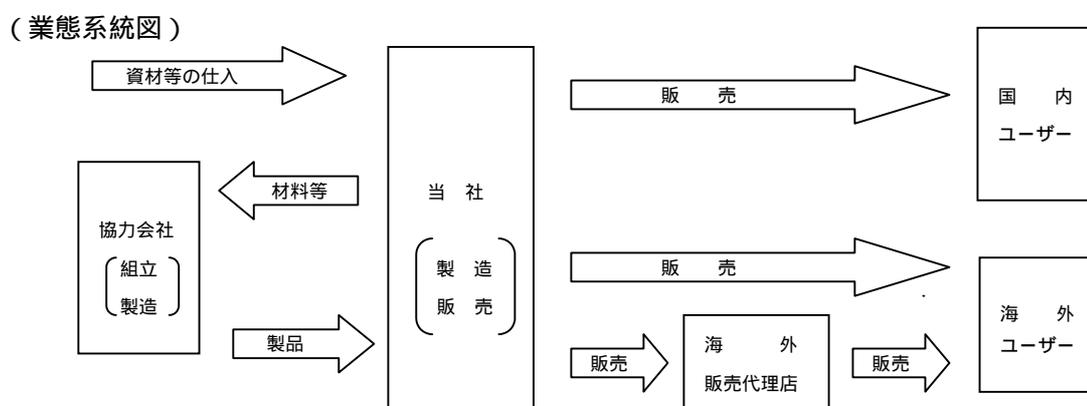
1. 企業集団の状況

当社は、単独で事業を営んでおり、関係会社はありません。

当社は、半導体等電子部品製造装置メーカーで、薄膜形成・加工装置の製造及び販売を事業としております。当社の基本となる薄膜形成技術はCVD法（Chemical Vapor Deposition = 化学的気相成長法）によるもので、当社の各装置においては、ナノテクノロジーと言われる10nm～100μmまでの成膜や加工が可能であります。（nm = ナノメートル：10億分の1メートル μm = マイクロメートル：1百万分の1メートル）

当社の装置は、薄膜を形成するCVD装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品出荷の前に独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行うとともに、海外については一部現地販売代理店に委託しており、これらの関係を図示すると以下の通りとなっております。



当社は装置等を以下の通りに区分しております。

(CVD装置)

反応性の気体を基板の上に堆積させる装置で、一般に減圧下で半導体の絶縁膜、光学薄膜などを形成するために使われます。特に当社は発火性のガスを使用しない液体原料を活用したLS-CVD装置（LS = Liquid Source）に特徴があり、比較的低温反応で成膜速度が速く、均一性の良い成膜が可能です。

(エッチング装置)

各種半導体の基板の膜をはじめ微細加工に必要な材料を切削加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻していくものです。当社はICP（Inductive Coupled Plasma = 高密度プラズマ）を利用したエッチングに特徴があり、高速でかつ選択比に優れた加工が可能です。

(洗浄装置)

当社の装置は溶液を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求される3次元実装などに必要とされております。

(その他装置)

上記装置には含まれない特別な装置であります。

(その他)

部品、保守メンテナンスなどがあります。

2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社は『薄膜技術で世界の産業科学に貢献する』ことを経営理念とし、社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値の追求を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。を経営方針に掲げ、事業を展開しております。

(2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けております。経営体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。尚、当社は、昨年設立 25 周年を迎え、業績も順調に推移いたしておりますことから、株主各位に感謝の意を表するため、第 25 期は普通配当の 12 円 50 銭に設立 25 周年記念配当の 2 円 50 銭を加え 1 株につき 15 円 00 銭の配当を実施いたしました。

(3) 投資単位の引き下げについて

当社は、当社株式の流動性の向上と株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。特に 1 単元株式数の見直しによる株式投資単位の引き下げにつきましては、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるために実行すべき課題として認識しており、平成 16 年 12 月 1 日付をもって 1 単元の株式の数を 1,000 株から 100 株に変更いたしました。

(4) 中期的な会社の経営戦略

当社は化合物半導体を中心としたオプトエレクトロニクス分野に経営資源を集中しながら、中期的には次の 3 点について戦略を展開してまいります。第一は、既に各種バックライトとして実用化の盛んな LED (Light Emitting Diode = 発光ダイオード) や次世代大容量光ディスク用途向けに注目されている LD (Laser Diode = 半導体レーザー) の量産化への対応及び各種センサーやチップが日々開発されて拡大している各種電子部品分野等への対応のため、本格的な量産用装置を開発し、メンテナンスを含めた販売力を強化していくことであります。第二は、これらの分野も含めて、量産用と研究開発用が同時進行で拡大している中国市場への積極展開であります。中国市場では既に商社と提携している一方、昨年 11 月に自社の拠点を上海に設置し、販売力の強化とアフターサービスの向上を図っております。第三は、CVD 装置、エッチング装置、洗浄装置といった当社の三大製品群に匹敵する IT 分野の第四の柱を確立することです。当社は、米国シリコンバレー、英国ケンブリッジとの 3 極体制で行っている研究開発と国内の大学や各種クラスターとの共同研究を行っておりますが、これらの中から、薄膜事業に関連する新事業、新分野をいち早く立ち上げ、当社の中期的な事業拡大に寄与する事業に成長させたいと考えております。

(5) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

当社では、効率的で健全な企業経営システムを構築する上で、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な経営課題であると認識しており、常に組織の見直しと諸制度の整備に取り組んでおります。株主総会は、設立時からの 7 月決算を貫くことにより、参加しやすく開かれた総会を目指しており、また取締役会は、意思決定の迅速化と経営責任を明確化するため、月 1 回以上の開催を定例化し、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、監査役の参加のもと、業務の執行状況を管理監督しております。当社の取締役は 6 名ですが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しながら、開かれた運営を基本としております。当社は監査役制度を採用しておりますが、監査役は 4 名のうち 3 名は社外監査役であり、取締役の職務執行の適法性と妥当性をチェックし、公正な意見が発言できる仕組みを作り上げております。監査役 4 名のうち中野淑夫氏は、当社の顧問会計士です。山田史郎氏、木村隆之氏及び藤岡孝雄氏と当社との間に取引関係その他の利害関係はありません。内部統制については、社長室が年間計画に基づく業務監査を実施して、内部牽制の実効性を高めております。今後も、経営内容の透明性を高め各ステークホルダーから信頼される企業を目指して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

(6) 対処すべき課題

現状の認識について

現状、デジタル家電関連の設備投資には一服感が見られますが、今後白色および青色 LED、LD が牽引役となるオプトエレクトロニクス市場では、自動車関連部品や一般照明用に巨大市場の出現が予

想されます。また、液晶に代わる次世代のディスプレイとして期待される有機 EL(Electro Luminescence)用途などの表示デバイス分野や三次元実装などで高性能化を進める電子部品分野での需要の拡大が見込まれます。これまで当社装置の中心的用途となっていた研究開発用途に加え生産用途としての量産用装置の開発と販売・メンテナンス体制の確立を急ぐことが重要と考えております。また、これらの展開はグローバル化しており、特に中国市場は重点市場として昨年 11 月に開設いたしました上海事務所における拡販が重要であると認識しております。

当面の対処すべき課題の内容

当面の課題は前期に投入致しました量産用 CVD 装置と独口パート・ボッシュ社より技術導入致しました「ボッシュプロセス」を取り入れた ICP ドライエッチング装置の販売力強化であります。また、オプトエレクトロニクス分野の LED、LD 用途向けの新型 MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)装置の開発も重点的課題であります。そのためには、経営資源の集中とより一層の人材育成が必要であると考えております。

対処方針

量産用装置の販売力強化はスケジュール通り実行中であります。適材適所の人材については、スキル保有人材を中心に各方面に広く門戸を開放し、中途採用を強化するとともに、独自の社内研修システムを確立していく方針であります。

具体的な取組み状況等

設立 25 周年の昨年、量産機分野への本格的参入による新たな成長に向けての決意を社内外に表明し、新しい企業イメージをアピールするため、平成 16 年 12 月 1 日付で旧商号「株式会社サムコインターナショナル研究所」から新商号「サムコ 株式会社」へ社名変更いたしました。今年 2 月 1 日には組織変更を行い、生産機事業部を新設いたしました。専任部署として開発から設計・営業・製造・納入までの全工程を一元的に統括管理し、新市場の開拓、顧客ニーズへの対応強化による拡販をめざします。また、重点部門を絞った中途採用人材の募集のみならず、広く事業拡大に伴う業務提携についても検討中であります。ただし、先方の技術力の評価と当社の業容との相乗効果を考慮しながら決定していく方針であります。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 当中間期の概況

当中間期のわが国経済は、期初から景気拡張期終焉の兆しが見られ、円高、原油高の悪影響からも景気後退が懸念される中で、企業収益の改善による今後の設備投資動向、雇用情勢や個人消費も力強さを欠き景気は踊り場から抜け出せない状況で推移いたしました。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましても、昨年夏以降米国向けのデジタル家電の輸出が減少基調となり在庫が積み上がり調整を迫られる状況が続きました。

こうした環境の中、当社の販売の中心分野である LED や LD などの光源用途とレンズ用途を柱とするオプトエレクトロニクス分野向けと、各種センサー用途やマイクロマシン用途を中心とする電子部品分野向けの販売が、CVD 装置、エッチング装置ともに弱含みで推移いたしました。かつ新製品(量産用)の販売展開の遅れにより一部大型装置の出荷が下半期にずれ込みました。洗浄装置については、LED 用途や液晶に代わる次世代のディスプレイとして期待される有機 EL(Electro Luminescence)用途などの表示デバイス分野向けに着実に受注を獲得いたしました。海外向けでは、前期に受注した台湾向け青色 LED 製造用途の大型装置や韓国向けでシリコン半導体の欠陥解析用途のリピートオーダーが寄与し、海外売上高比率が前期の 17%から 19.5%へ増加いたしました。製品開発では、各種デバイス材料として用途が拡大する化合物半導体分野向けに開発した量産用 CVD 装置および微細化・高精度化が進展するマイクロマシン分野や電子部品分野向けに、独口パート・ボッシュ社よりの技術(ボッシュプロセス)導入で開発したシリコンの高速ディープエッチング(深掘)装置の性能向上を図りました。また、三次元実装用の量産機の開発など成長分野に的を絞った積極的な研究開発活動を推進致しました。一方、当社とキリンビール株式会社で共同開発したペットボトル内壁への炭素薄膜コーティング技術が、ライセンス供与先によって実用化され、装置製造とペットボトル販売の両方で特許権使用料の受取りが始まりました。前期に引き続き、仕入原価や製造原価などのコスト削減に努めました。

以上のような活動をしてまいりましたが、当中間期は装置の総販売台数が 66 台(前年同期比 8 台減)に留まり、売上高は 1,541,869 千円(前年同期比 8.8%減)となりました。経常利益は円高の進行による為替差損も影響し 112,677 千円(前年同期比 35.6%減)、中間純利益は 70,808 千円(前年同期比 34.0%減)となりました。

(CVD 装置)

マイクロマシンのテスター用や表示デバイスの研究開発用途向けに大型装置の受注が獲得できましたが、前期好調であったオプトエレクトロニクス分野でデジタルカメラ等に搭載されるマイクロレンズ成型過程で使用される薄膜形成量産装置の需要が減少し、上半期の売上高は 412,964 千円(前年同期比 10.9%減)と減少致しました。下半期は、量産用途向けの出荷、有機 EL 等、FPD(Flat Panel Display)分野の封止膜用途での出荷が期待されます。

(エッチング装置)

電子部品加工用や石英ガラスのエッチングで特に研究開発用としてコストパフォーマンスに優れた小型装置の RIE - 10NR が国内外の大学向けを含め引き続き販売が堅調でした。生産用途では海外向けに半導体回路の欠陥解析用で受注が獲得できましたが、一方で、国内のオプトエレクトロニクス分野で一服感が見られました。その結果、上半期の売上高は 721,817 千円(前年同期比 13.7%減)となりました。

(洗浄装置)

従来の BGA(Ball Grid Array = 表面実装アレーの一種)基板の洗浄用途に加え青色 LED 実装前のクリーニング用途、有機 EL 等表示デバイスの表面処理用途等で幅広い需要があり、上半期の売上高は 204,030 千円(前年同期比 1.5%増)となりました。

(その他装置)

当中間期の売上はありません。

(その他)

既存装置のメンテナンスや改造及び部品販売が比較的安定的に推移し、売上高は 203,057 千円(前

年同期比 7.3%増)となりました。

(品目別売上高)

品 目	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
C V D 装 置	412,964	26.8	10.9
エッチング装置	721,817	46.8	13.7
洗 浄 装 置	204,030	13.2	1.5
そ の 他 装 置	-	-	-
そ の 他	203,057	13.2	7.3
合 計	1,541,869	100.0	8.8

なお、当社は装置により製造される半導体等電子部品をその用途により、LED・LD関連のオプトエレクトロニクス分野、各種センサー・磁気ヘッド・水晶デバイス・高周波デバイス等の電子部品分野、有機EL等の表示デバイス分野、半導体パッケージ技術や表面洗浄技術等の実装・表面処理分野、その他分野、部品・メンテナンスに分類しており、その売上構成は次の通りであります。

(用途別売上高)

用 途	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
オプトエレクトロニクス分野	475,104	30.8	16.3
電 子 部 品 分 野	605,938	39.3	4.0
表示デバイス分野	102,400	6.6	22.5
実装・表面処理分野	56,650	3.7	54.8
そ の 他 分 野	98,718	6.4	121.5
部品・メンテナンス	203,057	13.2	7.3
合 計	1,541,869	100.0	8.8

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は税引前中間純利益が112,677千円(前年同期比35.9%減)となり、仕入債務が29,633千円増加したものの、売上債権が97,627千円、たな卸資産が66,109千円増加し、借入金の返済72,660千円(うち短期借入金純増加額339千円、長期借入金減少額73,000千円)などにより、資金残高は前期末に比べ203,398千円減少し、当中間会計期間末には966,934千円(前年同期比22.1%減)となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は21,333千円(前年同期に得られた資金254,593千円)となりました。これは主に税引前中間純利益の112,677千円(前年同期比35.9%減)と仕入債務の増加29,633千円がプラスに寄与した一方、売上債権が97,627千円、たな卸資産が66,109千円増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は24,156千円(前年同期比87.3%増)となりました。その主な内容は有形固定資産の取得による支出が15,527千円、定期預金の払戻による収入969,848千円に対して預入による支出が978,165千円であったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は145,997千円(前年同期比37.9%減)となりました。これは、短期借入金の純増加額339千円に対して、長期借入金の返済による支出73,000千円と配当金の支払73,337千円によるものです。

(3) 通期の見通し

通期の見通しにつきましては、携帯電話やデジタル家電の需要減少に伴う各種デバイスメーカーの設備投資の見直しも予想されますが、オプトエレクトロニクス分野および電子部品分野で足元の受注状況が堅調に推移しているほか、FPD 分野において有機 EL 基板への封止膜形成用 CVD 装置や三次元実装用途向けに CVD 装置とエッチング装置のセットでの販売が期待されます。また、産官学のナノテク関連の研究開発分野でも安定した受注が見込まれます。更には、研究開発用途向けの市場で利益率を維持し、量産用途向けの市場では利益率を柔軟に設定することで競争力を発揮します。下半期に新設いたしました生産機事業部の積極的な営業展開により売上高の拡大を目指します。売上総利益率は、設計段階からの標準化をより一層推進しコストダウンを図り 50%を目標といたします。販売費及び一般管理費は、研究開発投資および中途採用人材に関する人件費に対して、引き続き資源の投入を予定するものの、固定費の増加要因は限定的と見ており、対売上高比率は低下できるものと予想しております。

以上のとおり新製品投入や新技術導入の効果が下半期より本格的に現われてくることから、売上高は 3,500 百万円（前期比 3.7%増）、経常利益は 455 百万円（前期比 10.5%増）、当期純利益は 273 百万円（前期比 8.7%増）となる見込みであります。